

【原因、判断要点、发生工序】由于 SR 网版背面玷污或者 AWF 的针孔等而引起的（SR 图形印刷、曝光工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by a stained back side of a solder resist printing screen or a pinhole on a phototool (Solder resist application process)

2-3-2-2 SR エッジ厚不足／SR 边缘厚度不足／Insufficient solder resist thickness at a conductor edge

【特徴】回路導体エッジ部の SR 厚が仕様厚に満たない状態の欠陥

【特征】在线路边缘的 SR 厚度不满足标准的缺陷。

【Characteristics】Solder resist thickness at the conductor edge is less than a specified thickness.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR インクの粘度が低過ぎたり、印圧や印刷速度が不適切だった場合にできるもの（SR 印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR 油墨的粘度太低或者印刷压力、印刷速度不合适所引起的（SR 印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by too low a viscosity of solder resist ink, or an improper printing pressure or squeegee speed (Solder resist printing process)



【コメント】
顕微鏡倍率×60

【注釋】
显微镜倍率 ×60

【Comments】
Magnification: ×60



【コメント】
銅見えと同居している
顕微鏡倍率×25

【注釋】
与露铜并存
显微镜倍率 ×25

【Comments】
Coexists with an
exposed copper.
Magnification: ×25

2-3-2-3 鉄基板 SR 傷表面微細傷／铁基板的 SR 表面的微裂痕／ Fine scratch on solder resist on iron-base printed board

【特徴】鉄基板 SR 表面に浅い微細な傷がある状態の欠陥

【特征】铁基板的 SR 表面有比较浅的细微伤痕的缺陷。

【Characteristics】A fine scratch exists on solder resist on an iron-base printed board.

【原因・判断ポイント・発生工程】硬化した SR の表面に鋭利な刃物もしくは硬く微細な異物が接触して出来たもの（SR 印刷工程後）

【原因、判断要点、发生工序】硬化的 SR 表面接触锋利的刀具或者坚硬的细微杂物所引起的（SR 印刷工序后）。



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×